科学研究費補助金研究成果報告書

平成21年6月26日現在

研究種目:若手研究(B) 研究期間:2007~2008 課題番号:19760478 研究課題名(和文)ナノ耐熱ポリマー層で接合したフレキシブルなセラミックス積層材料 研究課題名(英文) Flexible laminar ceramics composites bonded with nano-layer of heat resistant polymer 研究代表者 垣澤 英樹(KAKISAWA HIDEKI) 独立行政法人物質・材料研究機構 コーティング・複合材料センター 主任研究員 研究者番号:30354137

研究成果の概要:

高周波マグネトロンスパッタと真空蒸着重合装置を連結させた2槽連結型成膜装置中でAl₂0₃、 ポリアミド酸を交互に成膜することを繰り返し、その後加熱イミド化を行うことにより Al₂0₃/ ポリイミドナノ積層材料を得ることに成功した。成膜時間を変化させることにより、膜厚を制 御する方法を確立した。得られた材料は表面の局所的な圧縮負荷に対して損傷許容性を持つこ とを確認した。さらに、波形の表面を持つ基板に成膜を施すことにより、波形のナノ積層材料 を得ることに成功した。

交付額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2007 年度	1, 600, 000	0	1, 600, 000
2008 年度	1, 600, 000	480, 000	2, 080, 000
年度			
年度			
年度			
総計	3, 200, 000	480, 000	3, 680, 000

研究分野: 工学

科研費の分科・細目:材料工学・複合材料

キーワード:ナノ複合材料、バイオミメティクス、貝殻真珠層、ナノ高靭化機構

1. 研究開始当初の背景

デバイスの小型化やナノテクノロジーの 進展に伴い、ナノテク用基板材料や保護材料 として数~数百ミクロンの薄さで且つ優れ た力学特性を持つ複合材料が必要になると 考えられる。また、パーツのサイズがミクロ ンオーダーになっているマイクロマシン分 野でも、そのサイズで信頼性を維持できる軽 量な材料があれば構造用部材として大変有 用である。このようなディメンジョンでは、 複合構造のオーダーがサブミクロン以下の ナノ複合材料が求められる。ナノ複合構造特 有の力学特性を発現し、かつ機能性も付与で きる複合材料を実現できれば、ナノテクノロ ジーを支える技術として多くの応用が期待 できる。 応募者は、セラミックスの最大の弱点で ある脆さを克服するため、繊維や粒子を複合 化したセラミックス基複合材料(CMC)の研 究を行ってきた。CMCは、材料内部に「小さ な」破壊を多数累積させることにより、見か け上大きな伸び(大きな破壊抵抗)を示す材 料である。小さな破壊を累積するためには、 弱い界面を導入した複雑な組織を作ること が必要である。一方で、強度や弾性率を上げ るためには、欠陥を徹底的に排除し均一な組 織を作らなければならない。累積する破壊の ディメンジョンが数~数十ミクロンである 現状では、

- ・ 強度と靭性を両立することは非常に困 難である
- ・ 部材のディメンジョンが数~+ミクロ ンオーダーの場合、ミクロンオーダーの 破壊の累積では信頼性を確保できない
- ことを指摘してきた。

また、応募者は、ここ数年では、アワビの 貝殻真珠層の高靭化機構の解明やそれを応 用した材料作りに取り組んでいる。アワビの 貝殻真珠層は、厚さ数百ナノメートルの炭酸 カルシウム層と数十ナノメートルの有機層 が交互に積層された有機/無機ナノ複合材料 で、炭酸カルシウムとしては非常に高いレベ ルで強度と靭性の両立を実現している(引張 強度 100-200MPa、ヤング率 60-73GPa、破壊 エネルギー数百 J/m²)。アワビの真珠層の高 靭化機構はいくつものメカニズムが多段階 で働く複雑なもので、重要な知見がここ 10 年ほどで次々に明らかになっている。大きく 2つに分けると、

・ ミクロンオーダー以下の微細な構造
 を非常に均一かつ緻密に形成し、マイク
 ロクラッキング、亀裂偏向、プルアウト
 などの「小さな破壊の累積」を人工材料
 より2桁小さいオーダーで発現させる、

 特殊な変形挙動を示す有機層を持ち、有 機層自身が変形しエネルギー吸収を行っ たり、亀裂近傍の応力の再分布を行わせ たりする

ことである。特に、体積率にしてわずか数% に過ぎない有機層が大きな役割を果たすこ とが注目されている。こうしたアワビの高靭 化機構をアルミナなど実用性の高いエンジ ニアリングセラミックスに適用すれば、セラ ミックスの強度やその他の特長(弾性率、絶 縁性、熱膨張係数、etc.)を犠牲にせずに高 靭化を実現でき、しかも、薄い部材でも信頼 性を確保できる可能性があるのではないか と思い至った。さらに、構造を平面ではなく、 三次元の波状の積層にすれば、界面で剥離が 生じても亀裂が進みにくく、また、外部から の荷重に対して大きなフレキシビリティも 付与できるのではないかと考えた。

2. 研究の目的

カ学的、熱的、化学的に優れた特性を持ち 最も汎用性の高いアルミナを無機層に、耐熱 性、延性、絶縁性が高く応力緩和膜や表面保 護用としてエレクトロニクス分野で広く使 用されているポリイミドを有機層に用い、以 下の研究を行う。

- (1) 数百 nm の厚さのアルミナ層と数十 nm の ポリイミド層を交互に積層したアルミ ナ/ポリイミド多層積層材料のプロセス を検討する。
- (2)(1)で確立したプロセスを応用し、波状 の積層構造を持った材料を作製する。
- (3) 作製した材料の破壊抵抗および強度の 測定、微細な亀裂進展挙動のその場観察 を行い、最適な積層構造(層厚、波形の 形状など)を検討する。
- 3.研究の方法
- (1) サブミクロンオーダーの Al₂0₃ およびポ

リイミド膜を作製する方法として、スパ ッタ法および真空蒸着重合をそれぞれ 検討した。A1,0,膜は、高周波マグネトロ ンスパッタ装置を用い、真空度 5×10⁻⁴ Pa 以下で Ar ガスを導入し、0.1 Pa、室 温で成膜を行った。成膜時間を1-3hで 変化させた。ポリイミド膜は、以下のよ うに作製した。まず真空度 3.0×10⁻³ Pa 以下で無水ピロメリト酸(PMDA)とビス エーテル(BDA)をそれぞれ 443、423 K で 昇華させ、重合させながら288 K以下に 水冷したガラス基板上に蒸着し、ポリイ ミドの前駆体であるポリアミド酸を成 膜した。ついで大気中で昇温速度3K/min で 573 K まで加熱後、1 h 保持し、加熱 イミド化を行い、ポリイミド膜を得た。 蒸着時間を1-4hの間で変化させた。原 子間力顕微鏡を用いて Al₂O₃、ポリイミド の膜厚を調べた。

(2) (1)の結果をもとに、高周波マグネトロンスパッタと真空蒸着重合装置の2槽連結型成膜装置中でAl₂0₃、ポリアミド酸を交互に成膜することを繰り返した。その後加熱イミド化を行い、Al₂0₃/ポリイミドナノ積層材料を作製した。成膜時間および層の数は、Al₂0₃層は60minで20層、ポリアミド酸は4-30minの間で変化させ19層とし、ポリイミド層の厚さが異なる3種類の積層材料を作製した。



Fig. 1 ナノ積層材料作製装置の概略図

- (3) (2)で作製した積層材料についてマイク ロインデンテーション試験を行った。圧 子は、バーコビッチ圧子および球状圧子 (先端曲率半径=20 µm)を用いた。得ら れた荷重-深さ曲線の除荷部分からヤ ング率および硬さを計算した。また、圧 子の押し込みで生じた変形・破壊を観察 するため、表面を走査型電子顕微鏡 (SEM)および光学顕微鏡で観察した。さ らに、集束イオンビーム装置を用いて、 圧痕下部分を切断し、断面を SEM にて観 察した。
- (4) 波形の積層体を作製するため、波長 3・m、 高さ 170nm の波形の表面を有する A1 蒸 着エポキシ基板に積層材料を作製した。
 成膜時間は Al₂0₃層は 40 min、ポリアミ ド酸は 10 min とした。
- 4. 研究成果

(1) Fig. 2はA1₂0₃及びポリイミドの成膜時 間と厚さの関係である。この結果より、A1₂0₃、 ポリイミドの成膜速度は、それぞれ150、280 nm/hであった。膜厚を成膜時間によって制御 できることが明らかになった。加熱後の材料 のFT-IR解析によりポリイミドの生成が確認 された。また、X線分析により、A1₂0₃層は、ア モルファス状態であることが明らかになった。 これらの結果から、A1₂0₃/ポリイミドナノ積層 材料を作製するための条件を決定することが できた。また。成膜時間を変化させることに より、膜厚を制御できることが確認できた。



Fig. 1 Al₂0₃及びポリイミドの成膜時間と厚さの 関係。

(2) A1₂0₃、ポリアミド酸を交互に成膜した後加熱イミド化することによって得たA1₂0₃/ポリイミドナノ積層材料の断面組織をFig.3に示す。灰色、黒色の層が、それぞれA1₂0₃層(厚さ150 nm)、ポリイミド層(厚さ40-150 nm)であり、各層が交互に平行に積層していることが確認できた。また、成膜時間を変えることによって厚さを制御した積層材料を作製することができることを明らかにした。組織写真をもとに、3種類の積層材料中のポリイミド層の体積率を計算したところ、8、18および32 vol.%であった。



Fig. 3 作製した積層材料の断面組織 SEM 写
真: (a) ポリイミド層 4 min 成膜の積層材
料断面組織、(b) (a)の拡大写真、(c) ポ
リイミド層 30 min 積層材料断面組織

(3) Fig. 4 に球状圧子のインデンテーション
 試験の圧痕を示す。Al₂0₃単層では環状クラックの存在が観察されたが、積層材料では

圧痕表面やその周りにクラックは見られ なかった。また、ポリイミドの体積率が高 い積層材料では、圧痕周囲に表面の隆起が 確認できた。球状圧子の圧痕下の断面観察 から、ポリイミド層を複合化させた積層材 料では、脆性材料に特徴的である円錐状き 裂の発生が妨げられていること、A1,0,とポ リイミドの界面での剥離、Al₂0。層のせん断 方向への変形が生じていることが明らか となった。このことから、A1203/ポリイミ ド積層材料中で、高靭性セラミックスが示 すような損傷領域が形成されているため、 一般的な脆性材料に見られるクラックの 発生が抑制されたと考えられた。Fig. 5 に バーコビッチ圧子を用いたインデンテー ション試験での圧痕下断面組織写真の一 例を示す。Al₂0₃とポリイミドの界面での剥 離に続いてAl₂O₂の変形が起きていること が明らかとなった。圧痕周囲の隆起は、材 料内部の界面剥離によるものと考えられ る。以上から、有機層の変形や無機層の変 形、有機無機層間の界面での剥離などの機 構により、局所的な圧縮に対し見かけ上大 きな変形を許容することが明らかになっ た。A1₂0₃/ポリイミド積層材料は、セラミ ックスの耐損傷表面材料として有効であ ると考えられる。



Fig. 4 球状圧子押し込み試験後の圧痕表面の様子
 (a) Al₂0₃単層膜(b) ポリイミド層 4 min 成膜の
 積層材料



Fig. 5 バーコビッチ圧子押し込み試験後の圧痕 下断面組織

(4) 図6に波形基板上に作製した積層材料の 断面を示す。Al₂0₃層、ポリイミド層とも に基板の波形に沿って積層がなされてお り、波長約3 μm、高さ150nmの周期的な 波状構造をもった積層材料を作製するこ とに成功した。



図 6 波形の基板上に作製した積層材料の 断面

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔学会発表〕(計3件)

- <u>H. Kakisawa</u>, N. T. B. Diem, Y. Kagawa "Fabrication of Organic/inorganic Nano- multilayer Composite by a Room Temperature Processing," The 3rd International Conference on the Science and Technology for Advanced Ceramics (2009).
- ② 大脇悠介、 垣澤英樹、 長沼環、 住友太郎、

香川 豊、「A1₂0₃/ポリイミドナノ積層複
 合材料の変形破壊挙動」、日本金属学会2
 007年秋季大会(2007).

- ③ 大脇悠介、<u>垣澤英樹</u>、長沼環、香川 豊、 「ポリイミド/Al₂0₃のナノ積層複合材料 の亀裂進展挙動の観察」、日本金属学会2 007年春季大会(2007).
- 6. 研究組織
- 研究代表者 垣澤 英樹(KAKISAWA HIDEKI) 独立行政法人物質・材料研究機構・ コーティング・複合材料センター ・主任研究員 研究者番号: 30354137
- (2) 研究分担者 なし
- (3) 連携研究者 なし